

# 3600 CH

半导体系列

## 高速芯片分选设备

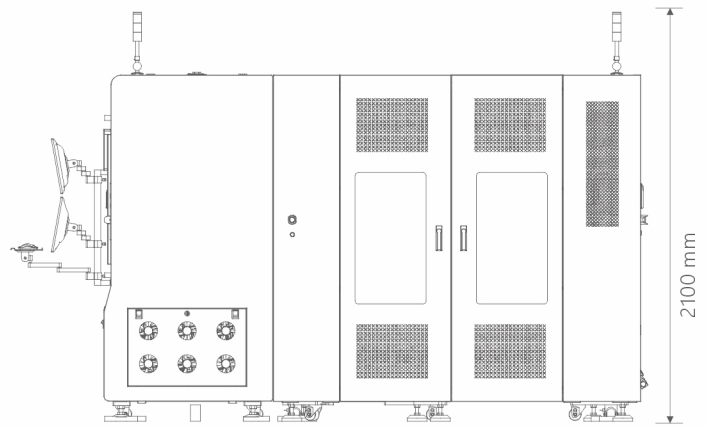
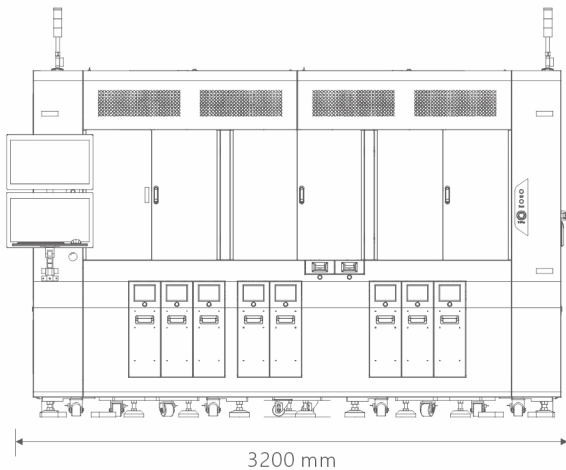


Cencorp 3600 CH用于芯片封装和测试的自动取放与模组分选,适用于光电芯片、集成芯片(IC)、微机电传感芯片(MEMS)、方形扁平无引脚封装芯片(QFN)等。

- 设备定位自动校准
- 可选产品翻转配置
- 二维码自动读取及识别追踪,方便数据追溯
- 设备维护方便,维护成本低,停机时间短
- 每小时产能(UPH)最高可达3600
- 自主研发软件系统
- 支持MES追溯系统和本地数据管理系统

# 3600 CH

## 技术参数



### 设备基本参数

宽度: 3200mm  
深度: 1560mm  
高度: 2100mm  
重量: 4688kg

### 设备精度

重复定位精度 (x, y, z):  $\pm 0.005$  mm  
系统精度:  $\pm 0.01$  mm

### 芯片处理能力

最小芯片尺寸 (x\*y): 1x1 mm  
最大芯片尺寸 (x\*y): 30x30 mm

### 基础功能

安全互锁门  
吸嘴间距可调节  
平均无故障间隔时间: 168小时  
平均辅助间隔时间: 4小时  
平均修复时间: 15分钟  
平均辅助时间: 3分钟  
静电防护等级: 0级  
噪音: < 75dB

### 用户界面

运行系统: Windows  
网络连接: 可选  
双显示器: 可选

### 视觉系统

自动校准  
二维码识别  
异常识别检测  
离线分析  
膜料识别

### 可选功能

坏板识别  
条码类型: 1D or 2D  
支持SECS/GEM  
绝对精度校准  
支持MES追溯系统  
本地数据管理系统  
离线编程

### 托盘处理能力

JEDEC 托盘  
定制托盘

### 轴性能

最大轴速度: 2000 mm/s  
最大轴加速度: 15000mm/s<sup>2</sup>

### 电气要求

电压: 交流 220/110V  
频率: 50/60Hz  
最大功率: 5KW

### 气源要求

气压: 5-7 bar

### 环境要求

工作温度: 10-40°C  
工作湿度: 30%-85%